



中华人民共和国国家标准

GB/T 8750—1997

半导体器件键合金丝

Gold wire for semiconductor devices
lead bonding

1997-12-22 发布

1998-08-01 实施

国家技术监督局 发布

前 言

本标准等效采用美国材料与试验协会 ASTM F72—94《半导体键合金丝》的基本内容,产品要求部分与 ASTM F72—94 等同,根据国内实际情况,在产品化学成分、拉伸试样长度、包装丝轴等方面略有区别。

进入 90 年代后,鉴于我国半导体器件键合金丝制造技术日趋成熟,生产水平不断提高,且金丝使用要求更加严格,GB 8750—88《半导体器件键合用金丝》目前已经不能满足国内使用要求。本标准对 GB 8750—88 做了全面修改,增加了金丝类型、规格、绕丝轴规定、丝的卷曲、轴向扭曲检验方法等内容,以使产品更好满足使用要求。

本标准自 1998 年 8 月 1 日起实施。本标准从实施之日起,代替 GB 8750—88。

本标准由中国有色金属工业总公司提出。

本标准由中国有色金属工业总公司标准计量研究所归口。

本标准由天津市有色金属研究所负责起草。

本标准主要起草人:曹颜顺、胡敏、石海仁。

本标准于 1988 年 2 月首次发布,于 1997 年 12 月第一次修订。

中华人民共和国国家标准

GB/T 8750—1997

半导体器件键合金丝

代替 GB 8750—88

Gold wire for semiconductor devices
lead bonding

1 范围

本标准规定了半导体器件键合金丝的产品分类、要求、试验方法、检测规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于半导体器件内引线用的拉伸或挤压金丝。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 8170—87 数值修约规则

GB 10573—89 有色金属细丝拉伸试验方法

GB 11066.5—89 金化学分析方法 发射光谱法测定银、铜、铁、铅、铈和铋量

GB/T 15077—94 贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

3 订货单内容

本标准所列材料的订货单内应包括下列内容:

- 3.1 材料名称。
- 3.2 金丝类型。
- 3.3 材料状态。
- 3.4 直径,单丝长度。
- 3.5 直径允许偏差。
- 3.6 丝轴形状、尺寸及绕丝方式。
- 3.7 标准编号,年代号。
- 3.8 包装形式及要求。

4 要求

4.1 产品分类

4.1.1 类型、状态、规格

金丝的类型、状态、规格应符合表1的规定。